

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026年8月27日、9月7日、9月8日)

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐专场机构交流会 ☒其他 2026年第三次临时股东会会议 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐现场参观
参与单位名称及人员姓名	现场出席/列席 2026 年第三次临时股东会会议的股东/股东代理人 中信建投 赵子鹏、国金证券 周焕博、国金证券 应明哲、明诚基金 李建君、 固禾基金 纪双陆、银华基金 陈晓雅、博时基金 何坤、大成基金 柴子钰
会议时间	2026 年 8 月 27 日 15:00-15:30 2026 年 9 月 7 日 16:00-17:00 2026 年 9 月 8 日 10:00-11:00
会议地点	南山智园崇文园区 3 号楼 3 楼 T3 培训中心 佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 孙成思 董事会秘书兼财务负责人 黄炎烽 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	Q1. 公司上半年的经营情况及公司各业务线条收入情况如何？ A1: 2026 年上半年公司实现营业收入 155.75 亿元，同比增长 298.10%，实现归母净利润 71.66 亿元，同比大幅增长。公司主要产品为智能移动及 AI 新兴端侧存储、PC 及企业级存储、智能汽车及其它应用存储，应用领域覆盖移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等多个领域，其中公司智能移动及 AI 新兴端侧存储收入 62.44 亿元，PC 及企业级存储收入 29.47 亿元，智能汽车及其他应用收入 62.33 亿元。 Q2. 能否介绍一下公司封测板块两大生产基地各自的定位以及工艺能力？ A2: 公司目前具备两大生产基地，包括位于惠州的泰来科技（存储器封测及 SiP 封测基地）及位于东莞的晶圆级先进封测制造基地（广东芯成汉奇）。泰来科技专精于存储器封测及 SiP 封测，目前主要服务于母公司的封测需求，部分产能服务于战略客户需求。泰来科技目前掌握 16/32 层叠 Die、30μm~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力。广东芯成汉奇已构建覆盖了 2.5D、RDL、Fan-in、Fan-out 等多种先进封装形式。 Q3. 请问公司如何看待本轮涨价周期的持续性？ A3: 根据 TrendForce 集邦咨询数据，2026 年第三季一般性 DRAM 合约价预计增长 13-18%，NAND Flash 合约价预计增长 10-15%。目前不同品类价格走势分化，部分品类持续上涨，部分持平。本轮存储涨价由 AI 算力需求爆发引起，公司将持续跟踪未来存储行业的发展趋势。

	Q4. 公司上半年存货增长比较快，是出于什么考量？ A4：公司积极进行战略性备货，2026 年上半年，公司存货为 181.68 亿元，相比 2025 年末增长 130.89%。目前整体库存较为充足，有效保障了公司长期稳定经营，支持未来快速发展。与此同时，公司持续深化与全球主要存储晶圆原厂的合作，持续签署 LTA（Long-Term Agreement，长期供应协议），锁定存储晶圆产能。为稳定核心原材料供应，匹配公司产能规划与中长期业务发展需求，降低存储行业价格周期性波动带来的经营不确定性，公司分别于 2026 年 3 月、6 月对外披露与存储原厂签署两份长期原材料采购协议，累计承诺采购金额 33.608 亿美元，以此锁定未来两年核心原材料供货资源。通过签署上述协议，公司一方面稳定核心原材料供货渠道，保障订单有序交付、巩固客户合作稳定性；另一方面通过长期锁价机制平滑行业周期波动，合理控制采购成本，稳定盈利水平，提升公司经营稳定性与市场竞争力。 Q5. 东莞晶圆级先进封测项目各产品线进展及产能规划如何？ A5：公司通过先进封装技术打造生态链，覆盖 AI 硬件基础设施“存、算、运”三大核心领域：“存”是面向先进存储芯片的 FOMS（扇出型存储堆叠）系列，满足大容量、高密度存储需求，公司已推出使用 FOMS-R 工艺的超薄 LPDDR 产品，该产品进展顺利，目前已经收到客户需求预测；“算”是聚焦计算与存储整合的 CMC（存算芯粒）系列，适配存算合封的技术发展趋势，公司 CMC 产品实现 10 颗 Chiplet 集成封装，目前已完成工艺开发样品制作；“运”是主攻高速信号传输的 OEC（光电共封装）系列，契合超高速互联的应用需求，公司 OEC 产品目前正在与客户合作开发 6.4T NPO 的光引擎封装，预计 2026 年第四季度完成研发。在产能规划上，公司晶圆级先进封测制造项目计划在 2026 年底实现月产能 5,000 片，并计划于 2027 年底提升至 10,000 片/月，如果客户导入顺利，预计将于 2026 年年底起正式贡献收入。通过该项目，公司将为客户交付“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案，进一步强化在存算融合领域的技术壁垒与市场竞争力。
附件清单	无
日期	2026 年 8 月 27 日、2026 年 9 月 7 日、2026 年 9 月 8 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。